

PÂTE THERMIQUE

THERMAL COMPOUND



- Pour microprocesseurs
- Excellente conductivité thermique
- Non conductrice au niveau électrique
- Composé de silicone, de carbone, d'oxyde de métal et d'oxyde d'argent

Code Article

1501079

Référence

VEN-PT-SILVER-COOL

Code EAN

3700284605454

CARACTÉRISTIQUES

- Pâte thermique de couleur argentée 1.5 g
- Conductivité thermique : $> 4.5 \text{ W/mK}$
- Impédance thermique : $< 0.205^\circ\text{C-in}^2/\text{W}$
- Température de fonctionnement : $-30^\circ\text{C} - 240^\circ\text{C}$

SPECIFICATIONS

- Silver color thermal compound 1.5 g
- Thermal conductivity: $> 4.5 \text{ W/mK}$
- Thermal impedance: $< 0.205^\circ\text{C-in}^2/\text{W}$
- Operation temperature: $-30^\circ\text{C} \text{ to } 240^\circ\text{C}$